

## 傳田 講演, 論文, 記事記録

題目	発表会,雑誌名	年月	講演場所	ページ	Remark
Silicon Through Hole Technology	ICEP 2006	1999.12.03	品川プリンスホテル		
フリップチップ実装における基板及びチップに必要な配線幅	MES 2001	2000.04.17	大阪大学	127	
一括積層基板と高速基板技術の現状	長野実装フォーラム第1回	2002.07.24	上田東急イン		
高速信号伝送用基板の最近の動向	マイクロファブ리케이션研究会第3回	2003.04.25	信州大学工学部	39	
薄型チップの動向と問題点	長野実装フォーラム第2回	2003.06.06	上田東急イン		
超高周波LSIパッケージの問題点	長野実装フォーラム第3回	2004.06.16	上田東急イン		
ナノテクノロジーと実装技術	JIEP 修善寺ワークショップ	2004.09.10	ラフォーレ修善寺	1	
高周波LSIパッケージの諸問題	JIEP講演大会	2005.03.18	理科大学野田校		
マスクレス配線形成技術の特徴と問題点	長野実装フォーラム第4回	2005.06.24	軽井沢プリンスホテル		
Wafer Level Packaging Technology in Japan	2000 IEMT/IMC	2006.04.00	大宮コンベンションセンター	4	
マスクレス配線形成技術の特徴と問題点	電子材料	2006.04.01		6	
ウエハーレベルパッケージの現状と問題点	電子情報通信学会技術研究報告 vol.99, No.484	2006.04.21	大阪大学	31	
シリコン貫通電極と問題点	長野実装フォーラム第5回	2006.06.30	軽井沢プリンスホテル		
Process Examination of Through Silicon Via Technologies	Polytronic 2007	2007.01.15	お台場未来館	149	
Evaluation of Through Silicon Via Technology	ICEP 2007	2007.04.18	品川プリンスH		
マスクレス回路配線基板作成と問題点	技術情報協会	2007.04.27	大井町きゅりあん	1	
基板への半導体チップ内蔵技術と問題点	長野実装フォーラム第6回	2007.05.23	上田東急イン		
TSVの技術分類と世界のTSV技術開発動向	長野実装フォーラム第7回	2007.06.29	軽井沢プリンスホテル	1	
新しい半導体パッケージング, TSV(Through Silicon Via)	セミジャパン研究会	2007.09.11	市ヶ谷セミジャパン	1	
ベアチップの品質保証とその問題点	長野実装フォーラム第9回	2007.10.02	上田パレオ		
3次元チップ積層のためのシリコン貫通電極(TSV)の開発動向	表面技術 vol 58	2007.12.01		14	
薄型チップのボンディング技術の動向	長野実装フォーラム第10回	2007.12.04	軽井沢大賀ホール	1	
TSVが導く新たなビジネスチャンス	ABSMセミナー	2008.01.30	くまもと県民交流館	1	
シリコン貫通電極(TSV)の製作プロセスと問題点	JIEP講演大会	2008.03.17	東京大学	55	
シリコン貫通電極(TSV)の製作プロセスと問題点	電子材料 2008.5月号	2008.05.01		42	
貫通電極による三次元実装技術の動向と課題	JIEPマクロナノファブ리케이션研究会	2008.05.28	JIEP会館	1	

TSV技術のMEMSへの応用	SFJ 2008 MEMSセミナー	2008.06.20	グランキューブ大阪	1	
MEMSの貫通電極	長野実装フォーラム第12回	2008.06.27	軽井沢プリンスホテル		
シリコン貫通電極技術の課題	ISTF 2008 SEAJ/SEMI	2008.09.17	横浜パシフィコ	1	
半導体の3次元実装を実現するシリコン貫通電極の展望と問題点	グローバルネット	2008.10.06	総評会館	1	
実装接続技術(Ⅱ)	YJCjisso スクール深堀コース	2008.10.16	横浜国立大学	1	
TSVIによる三次元積層技術	SUSS Asian Seminar	2008.10.29	品川 東京CC		
シリコン貫通電極技術の進展と課題	技術情報協会セミナー	2008.11.19	総評会館	1	
三次元実装技術の最先端を検証	プレスジャーナルセミナー	2008.12.18	学士会館	33	
Si貫通電極の最新技術動向徹底解説	電子ジャーナルセミナー 307	2009.03.05	総評会館		